



	<p>独立董事 邓磊</p> <p>独立董事 徐开兵</p> <p>证券事务代表 王琳</p>
<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p><b>1、公司当前在手订单情况如何？订单能见度是否能支撑 2026 年的业绩增长？</b></p> <p>答：您好，公司受益于消费电子行业大客户创新性需求、AI PCB 行业需求的增长、锂电行业储能产业带动的设备需求增长，为公司今年经营业绩持续增长提供了保障。</p> <p><b>2、2025 年公司 PCB 业务（尤其是 AI 相关设备）表现亮眼，请问该业务 2026 年的订单、客户拓展及产能规划如何？是否会成为公司未来业绩的核心增长引擎？</b></p> <p>答：您好，2025 年度公司 PCB 业务表现突出，实现营业收入 57.73 亿元，同比增长 72.68%。其中，AI 算力产业链带动的高多层板、HDI 板及先进封装设备需求强劲，公司通过 CCD 六轴独立机械钻孔机、新型激光钻孔机等创新技术方案持续巩固市场领先地位，并获国内外龙头客户认证。2026 年，公司将继续聚焦 AI 算力 PCB 行业的技术升级与全球化布局：1、订单与客户拓展：随着 AI 服务器、高速交换机等终端需求持续爆发，公司已与下游 PCB 龙头企业深化合作，订单增长显著，2026 年第一季度大族数控营收同比增长 103.69%。未来将依托一站式解决方案优势，进一步拓展东南亚等新兴市场；2、产能规划：公司计划通过构建国内外产能满足全球客户需求，并加速 18 层以上高多层板、先进封装载板设备等高价值设备产能释放；3、核心增长引擎：AI 产业相关的 PCB 业务因技术壁垒高、市场需求明确，叠加公司在钻孔、成型等关键工序的领先优势，有望成为公司业绩的核心驱动力。</p> <p><b>3、董事长您好，我来自《证券市场周刊》，有两个问题想请教：1、2025 年，公司 PCB 智能制造装备的毛利率同比增长 7.01%，原因是什么？未来毛利率能否保持在 30% 以上？2、公司如何展望 3D 打印设备的市场需求？公司是否会加大半导体设备的研发力度？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！2025 年 PCB 智能装备毛利率提升的原因主要为 AI 算力场景高技术产品占比增加，包含 CCD 机械钻孔机、高精度四线测试机等。公司将持续深耕 AI 算力场景，不断提升现有优势产品竞争力及新产品市场开拓</p>

力度，产品结构有望进一步优化，进一步提升综合盈利能力。3D 打印设备方面，公司聚焦消费电子钛合金结构件，环形光束技术等创新已实现效率提升 30%以上，2025 年消费电子设备营收增长 15.33%。随着智能眼镜、终端智能体等新硬件迭代，该业务有望保持 20%以上增速。半导体设备领域，公司晶圆切割、封测设备持续放量，正积极推进国产替代。感谢您对公司的关注。

**4、您好，请问公司未来发展发现是哪个主要的板块**

答：尊敬的投资者，您好！公司未来主要聚焦于信息产业设备、新能源设备、半导体设备、工业激光加工设备等板块的发展，具体请参照公司 2025 年年度报告第三节管理层讨论与分析的相关说明，谢谢！

**5、公司今年业绩主要增长方向是什么？**

答：您好，根据当前的行业发展趋势，消费电子行业大客户创新性需求、AI PCB 行业的需求、锂电行业储能产业带动的设备需求，将成为公司主要的业绩增长方向。

**6、您好，董事长，公司未来有没有新的规划发展，保持新的增长点呢？**

答：您好，公司去年业务增长及今年的发展态势深度受益于 AI 技术的带动，公司未来将充分利用公司自身平台优势，整合各方面资源，在现有业务的基础上，积极拓展与 AI 产业链相关各方面的业务。

**7、您好！请介绍一下大族激光旗下的 3D 打印业务，主要客户包括哪些，以及对未来 3D 打印这个行业发展的一些评估。**

答：尊敬的投资者您好，公司 3D 打印业务聚焦消费电子钛合金结构件，采用光纤激光器作为能量源，配置高精扫描振镜和成熟切片及路径规划软件，具备高速、高精、稳定可靠的特点，适用于不锈钢、铝、钛合金、模具钢等材料的打印。目前技术成熟度持续提升，已与 3C 消费电子领域的龙头企业建立长期深度合作，为行业提供更高效、更可控、更具成本优势的制造路径。相关产品详情可参考公司官网及大族聚维官网。关于 3D 打印行业前景，公司认为该技术在复杂设计、轻薄化和 ESG 等方面具有显著优势，随着新材料、新结构的持续突破，以及环形光束等创新技术的应用，3D 打印有望推动消费电子等领域的新一轮扩产周期。未来公司将通过红光/绿光金属打印设备等自主研发成果，进一步拓展航空航天、医疗齿科等高端应用场景。感谢您对公司的关注。

**8、公司今年年报净利润下降，第一季度净利润同比增长，是什么原因？是**

什么业务导致一季度净利润大幅增长？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2026 年 1~3 月归属于上市公司股东的净利润为 3.54 亿元，较上年同比增长 116.59%。净利润大幅增长的主要原因是公司报告期内公司下游市场需求强劲，公司主营业务收入同比大幅增长；公司 2025 年度归属于母公司净利润同比下降，主要是由于公司 2024 年度存在处置大族思特股权确认大额股权处置收益的影响，公司 2025 年度扣除非经常性损益后净利润 81,047.91 万元，较上年度增长 82.28%，具体请参照公司 2025 年度报告及 2026 年一季度报告的相关说明。谢谢！

9、公司原材料准备是否充足，各项材料的供给是否符合生产要求，同时原材料都在涨价的当下会不会影响公司的生产利润

答：尊敬的投资者您好：公司通过多年合作，对关键与重要物料均与上游供应商建立了良好的战略合作关系。公司采取了常规物料根据市场需求提前备货，大额采购进行招投标方式等措施。公司 2026 年一季度毛利率 34.02%，2025 年毛利率 33.28%，部分原材料涨价对公司利润的影响不明显。谢谢！

10、您好！从券商的研报中得知，大族激光在面板行业激光打孔项目首台设备完成客户验收，成功取得客户复购订单，单台设备价值达到 1 亿元。请问目前国内的面板行业对此设备的需求规模一年大概有多少？

答：您好，公司该设备客户为京东方，用于 OLED 生产线，已完全实现国产替代。未来设备需求取决于客户 OLED 生产线扩产意愿。

11、您好，想请教一下贵司 AIPCB 相关设备的在手订单增速，目前能达到多少？是否有明确的大客户落地？

答：您好，公司 2025 年年度 PCB 设备业务实现营业收入 57.73 亿元，同比增长 72.68%，主要受益于 AI 算力 PCB 行业的高景气度。公司在高多层板、HDI 板及先进封装领域的技术优势显著，已通过行业龙头客户的加工认证并实现量产，特别是在 AI 服务器相关 18 层及以上高多层板、高阶 HDI 板等高端产品市场占有率持续提升。目前，公司正积极把握全球 PCB 产业技术升级机遇，与下游客户共同开发创新型解决方案，但具体订单增速及客户名称涉及商业保密条款，暂不便披露。国内主流 PCB 厂商均为公司主要客户，目前正在东南亚地区加大资本开支积极扩产，具体信息可参考相关公司的公开信息。

12、大族激光除了布局了 AIpcb 设备，未来会不会涉及光模块 cpo 设备领

域？

答：您好，公司业务暂未涉及光模块 CPO 设备领域。

**13、您好，公司目前 AIPC、消费电子创新、高端面板、3D 打印多条高景气赛道同时发力，请问 2026 年二季度及全年，公司整体业绩环比、同比能否实现持续加速增长？目前的在手订单饱满度，是否已经可以支撑全年业绩大幅向好？**

答：尊敬的投资者您好，公司目前在 AI PCB、消费电子创新、高端面板及 3D 打印等赛道均展现出强劲的发展势头。全年来看，AI 服务器 PCB、高多层 HDI 板等需求持续旺盛，叠加消费电子供应链多元化机遇，公司产能及技术优势有望进一步释放。具体业绩情况请持续关注相关定期报告。感谢您对公司的关注！

**14、请问公司有拓展商业航天方面的业务么，网上看到说为蓝箭航天提供发动机激光焊接设备，为其一级供应商，是否属实。如有商业航天方面的业务，请介绍下进展。**

答：您好，蓝箭航天朱雀三号可重复使用运载火箭在国内首次采用不锈钢箭体，这一结构创新对制造工艺提出了极高要求，公司提供的精密激光焊接解决方案为火箭关键部件的可靠制造与整体性能的实现提供了重要支撑，具体内容请参阅公司微信公众号于 2025 年 12 月 23 日发布的文章《行业案例 | 精准焊接，共筑苍穹：大族激光智能装备集团激光焊接技术助力航天新里程》。商业航天领域相关业务情况因涉及商业秘密，不便过多透露，感谢您对公司的关注。

**15、您好，请问公司与消费电子大客户签订有多长时间的合作？约占公司业务的百分之几？**

答：尊敬的投资者您好，公司与消费电子领域客户的合作细节因涉及商业保密协议不便披露，具体业绩情况请持续关注相关定期报告。根据 2025 年年度报告，公司系消费电子行业大客户的核心设备供应商，深度参与到客户各类创新性消费电子产品的生产研发环节，在激光加工、3D 打印、自动化、密封检测等环节持续更新产品和工艺并实现技术突破。消费电子设备业务营业收入同比有所增长，这一增长源于全球消费电子行业正经历“AI 终端爆发+供应链重构”的双重变革。具体业务占比情况请以公司定期报告披露的数据为准。感谢您对公司的关注。

**16、您好，请问贵公司 AI 半导体用玻璃基板设备发展情况如何，是否已经**

有成熟的产品，对应的客户有哪些？已经交付了吗？交付金额大概是多少公司对这块业务 2026 年有哪些规划，谢谢

答：您好，公司在玻璃基板加工设备领域已取得阶段性成果：1、玻璃基板加工设备研发：项目处于小批量阶段，目标是先进封装市场提供高精度玻璃加工综合解决方案，技术效果达到行业领先水平；2、基于玻璃基板 TGV 的高精度高效激光钻孔技术：研发中，致力于突破大规模群孔加工技术瓶颈；3、光电子器件（玻璃）基板切割机：已开发样机，可实现更高程度自动化加工。目前相关技术已应用于先进封装领域，具体客户信息及交付金额涉及商业保密条款暂不便披露。2026 年公司将持续推进“ALL IN AI”战略，重点突破玻璃基板微孔加工、三维曲面切割等核心技术，进一步拓宽在先进封装领域的布局。感谢您对公司的关注。

**17、公司 3D 打印设备是否已经获得消费电子大客户订单，今后会成为消费电子板块的业绩增长点？**

答：您好，公司的 3D 打印业务聚焦消费电子钛合金结构件，技术成熟度持续提升，已为消费电子制造开辟了一条更高效、更可控、更具成本优势的全新路径。公司已与消费电子领域的龙头企业建立长期深度合作，联合开展新材料、新结构等技术攻坚，3D 打印环形光束技术显著提升了打印效率。2025 年消费电子设备业务实现营业收入 24.72 亿元，同比增长 15.33%，其中 3D 打印业务在金属增材制造等项目中提供领先解决方案，有望成为新的业绩增长点。感谢您对公司的关注。

**18、请问公司控股的特种光纤 Coractive 公司，现有产品和技术是否有应用于 AI 基建相关领域，能否具体介绍一下？**

答：尊敬的投资者，您好！公司控股的 Coractive 公司，主要为公司的核心器件提供配套的特种光纤，暂不涉及 AI 基建相关领域。谢谢！

**19、感谢高总及各位高管为公司发展做出的贡献，希望大族在高总的带领下越来越好，勇攀高峰！！**

答：尊敬的投资者您好！感谢您对公司的高度认可与支持。公司及管理层将秉持为全体股东创造价值的理念，不断提升经营效能，以优异的业绩回报投资者信任。再次感谢您的鼓励与关注！

**20、能否具体介绍一下公司的“ALL IN AI”战略内容，谢谢！**

答：您好，在 AI 算力爆发这一轮产业机遇中，公司聚焦 AI 算力场景，紧抓全新技术升级机遇，锚定钻孔工序，持续推高钻孔类解决方案的市场尖刀地位，发挥多产品、多场景的协同优势，不断研发适应 AI 算力场景技术的、具有市场竞争力的、覆盖 PCB 生产全流程核心工序的智能制造解决方案，不仅要从产品性能层面不断突破，更要从 AI PCB 全流程智造综合解决方案的维度实现新一代 AI PCB 产品的量产。同时，公司将以现有先进技术的核心工序解决方案为切入点，与下游龙头 PCB 制造商、上游关键器件供应商及 PCB 关键原材料厂商紧密合作，全面掌握行业内领先的生产技术和工艺变化趋势，构建起产业链上中下游一体化的研发联动机制，逐步将产品线从 PCB 关键工序向全工序进行延伸，深化 PCB 加工解决方案的一站式供应；并随着产品技术的进一步深化，助力 PCB 行业客户向先进封装产业拓展。

**21、高阶 SLP、HDI、高速板激光钻孔/微加工设备，目前头部算力板厂订单锁定情况？交付周期、溢价能力如何？**

答：您好，公司在 AI 算力 PCB 专用设备市场快速崛起，主要产品市场占有率及客户认可度持续攀升。针对高阶 HDI 板市场，公司持续与下游客户开展新材料加工工艺研究，是行业内少数可提供对应成套解决方案的企业，针对 AI 服务器相关高多层 HDI 板技术难度大的特点，公司提供机械钻孔机、CCD 六轴独立机械钻孔机、CO<sub>2</sub> 激光钻孔机、新型激光钻孔机的超强产品组合，不断巩固在钻孔核心工序的市场地位。

**22、面对 AI 服务器、高速铜箔、高频高速材料加工，公司激光设备相比同行的独家壁垒、不可替代性在哪？**

答：您好，随着 AI 算力 PCB 工艺的技术进步加快，产业进步依靠设备与材料的技术迭代完成，需要从业企业积累海量的工艺数据，公司依托深厚的客户群体及战略合作关系，从单纯的产品提升升级到融合人、机、料、法、环、测的成套工艺解决方案，并逐步推进不同工序间的有机协同，打造公司最核心的护城河。公司是行业内少数可为高附加值 AI 服务器用高多层 HDI 板、先进封装基板等提供成套创新解决方案的企业，相关产品如 CCD 六轴独立机械钻孔机、新型激光加工设备、超大点数四线测试机等已获得行业多家重点客户的高度评价。

**23、扁线电机、储能、光伏钙钛矿新设备，是否已经拿到头部企业定点？**

	<p><b>市场占有率怎么样？</b></p> <p>答：您好，光伏钙钛矿设备方面，公司在钙钛矿技术领域持续优化激光刻划设备工艺，市场占有率处于领先地位，并与极电光能、协鑫光电等行业头部客户保持良好合作。子公司大族光伏专注于钙钛矿技术路线，已建成中试线并推进产业化；储能设备方面，公司锂电设备业务积极拓展动力电池与储能电池装备市场，与宁德时代、亿纬锂能、海辰储能等主流客户深化合作，参与其全球化布局，公司通过技术创新和海外市场拓展提升竞争力；扁线电机设备方面，已经拿到量产线订单，正在交付收尾阶段，客户满意度较高；市场占有率方面，钙钛矿设备细分领域处于领先地位；锂电设备受益于海外扩张，营收规模增长。光伏设备受行业调整影响，但公司 TOPCon、BC 及钙钛矿技术布局有望在行业集中度提升中强化优势。</p> <p><b>24、东南亚 PCB 设备产能扩产项目，目前的建设进度和投产时间是怎样的？未来海外客户的收入占比目标是多少，能否有效对冲国内行业周期波动？</b></p> <p>答：您好，公司于 2026 年 2 月 25 日发布《关于设立海外运营中心的公告》，在东南亚设立的海外运营中心项目总投资不超过 1.5 亿美元，实施周期预计自取得建设用地或物业产权起算不超过 36 个月，目前处于选址阶段，具体建设进度将根据实际实施情况披露。关于海外客户收入占比目标，根据公开信息，东南亚 PCB 产业 2024~2029 年复合增长率达 7.1%，公司正大力扩充海外团队以把握供应链多元化机遇。公司当前国内产能能够满足东南亚等海外扩产客户的设备需求。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p><b>附件清单 (如有)</b></p>	
<p><b>日期</b></p>	<p>2026 年 4 月 28 日</p>